第十届中国LED产业健康发展高峰论坛

**会议日程表**

**时间：2016年4月8日 地点：深圳会展中心-6层郁金香厅**

**指导单位：** 工业和信息化部电子信息司 消费品工业司

**主办单位：** 中国半导体照明/LED产业与应用联盟

中国电子器材总公司

**承办单位：** 中电会展与信息传播有限公司

**支持媒体：**《中国电子商情》、中国电子报

**新浪微博：**@中国LED展

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2016/4/8** | **上　午** | |
| **时　段** | **内　容** | |
| **9:00-9:30** | **参会代表报到，嘉宾交流** | |
| **9:30-10:00** | **开幕式　工信部领导** | |
| **10:00-10:30** | **2015年我国照明行业发展综述与2016年展望** | **中国照明电器协会副理事长**  **陈燕生** |
| **10:30-11:00** | **半导体照明产业发展动态及新技术挑战** | **福建省光电子行业协会顾问**  **彭万华** |
| **11:00-12:00** | **IEC灯具标准现状** | **国家照明标准化技术委员会技术负责人 施晓红** |
| **12:00-13:30** | **午　餐** | |
| **2016/4/8** | **下　午** | |
| **时　段** | **内　容** | |
| **13:30-14:20** | **半导体照明技术标准工作现状与新标准解读** | **中国电子技术标准化研究院秘书长**  **赵 英** |
| **14:20-14:50** | **新型圆片级LED封装技术** | **江阴长电集团先进封装有限公司经理**  **陈 栋** |
| **14:50-15:20** | **CSP技术应用及发展趋势** | **广州晶科电子有限公司CEO**  **肖国伟** |
| **15:20-15:50** | **LED电子行业用密封胶产品及发展趋势** | **郑州中原应用科技有限公司副总工程师 胡生祥** |
| **15:50-16:20** | **Green Power Lighting City** | **上海华虹宏力半导体制造有限公司**  **科长 金 峰** |
| **16:30** | **会议结束** | |
| **日程以现场为准，组委会保留最终解释权** | | |

【**参会报名表**】

第十届中国LED产业健康发展高峰论坛

**参会报名表**

**时间：2016年4月8日 地点：深圳会展中心-六层郁金香厅**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | 中文 | |  | | | | | | | |
| 英文 | |  | | | | | | | |
| 地址 |  | | | | | | | | | 邮编 |
| 联系人 |  | | | 电话 | |  | | 传真 |  | |
| 手机 |  | | | email | |  | | 网址 | | |
| 姓 名 | | 职 务 | | | 手 机 | | E-mail | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
| **特别说明：**  请将此表填写完整并与3月31日之前回复邮件至指定邮箱。会议规格较高，听众名额有限，满额即止。  联系人：张志芬 电话： 010-68207975 010-68200773（传真） 邮箱：chinassla@163.com | | | | | | | | | | |

◆温馨提示：由于会议期间有大型展览，展馆周边酒店客房紧张，请提早预订。